
Pressemitteilung**02.11.2020**

Flexibilität auf kleinstem Raum

Kompakte SMT B-t-B Verbinder im Raster 1,27mm



In elektronischen Einheiten ist jeder Millimeter kostbar, denn auf kleinstem Raum muss ein kompaktes Innenleben funktionsfähig untergebracht werden. Genau für diese limitierten Platzverhältnisse liefert W+P die intelligente Antwort.

Variable Leiterplattenausrichtung

Kompakt, flexibel und zuverlässig sind die Attribute der Board-to-Board Verbinderserien **9025** und **9026** im Raster 1,27mm.

Sie stellen eine Erweiterung des W+P Portfolios an Leiterplatten-zu-Leiterplatten Schnittstellen dar, die dem wachsenden Bedarf an geringen Polzahlen mit kleinen Rastermaßen gerecht werden. Idealerweise sind die beiden einreihigen Serien schon ab einer Polzahl von 02 Kontakten lieferbar, bis zu 12 Kontakte sind maximal möglich.

Eine variable Leiterplattenausrichtung ist ein weiterer Vorteil der stehend und liegenden verfügbaren Steckverbinder, so ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, Platinen vertikal, horizontal oder rechtwinklig miteinander zu kombinieren.

Solide Befestigung auf der Leiterplatte

Das integrierte Gehäuse-Verriegelungssystem der Buchsenleiste gewährleistet einen sicheren Anschluss mit gleichzeitigem Verpolschutz, den Führungskanten im Innenteil zusätzlich unterstützen. Seitliche Lötwinkel übernehmen die Aufgabe einer soliden Befestigung von Stift- und Buchse auf der Leiterkarte.

Kontaktstifte sowie die doppelseitigen Federkontakte der Buchse sind selektiv vergoldet, einsetzbar sind diese bis zu einem Nennstrom von maximal 5 A.

Spezielle Positionierhilfen erleichtern die Ausrichtung auf eine definierte Stelle auf der Leiterplatte. Außerdem stellen Tape-and-Reel-Verpackungen und das optionale Pick-and-Place-Pad (Serie 9025) die ökonomisch automatisierte Bestückung im SMT-Fertigungsprozess sicher. Die Isolierkörper bestehen aus thermoplastischem Kunststoff gemäß UL94 V-0. Im Temperaturbereich von -55°C bis +125°C ist eine zuverlässige Funktion garantiert.

Optimale Einsatzgebiete sind Verbindungen von Leiterplatten und Anschlüsse interner sowie externer Geräte. Zu finden beispielsweise in der Automatisierungstechnik im Embedded Computing Bereich und in industriellen Anwendungen.

Muster und weitere Informationen können Sie unter: Info@menges-group anfordern.